

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	详见附件1《与会单位名单》
时间	2024年5月16日、17日
地点	北京线下会议
上市公司接待人员姓名	陈鲁 董事长、总经理 哈承姝 战略副总裁 古凯男 董事会秘书 周凡女 财务总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司最新订单情况，新增订单增速较快的原因及2024年全年预期情况。</b></p> <p>答：</p> <p>（1）公司近期新增订单情况良好，相较2023年有较为显著的增长，其中2024年二季度新增订单情况预计与一季度情况相近。</p> <p>（2）公司新增订单较快除了新增产品直接贡献外，得益于全面的产品布局，公司在向下游客户销售中，尤其是针对有批量设备采购需求的扩产客户，公司能够直接以多个系列产品组合的形式向客户销售，间接促进了公司订单的获取效率。这种趋势在随着公司产品结构日趋多元、新产品逐步成熟的过程中不断凸显。</p> <p>（3）今年全年来看，结合公司与主要客户合作基础、初步沟通意向等，取得订单的确定性较强，最终订单获取时间取决于客户的进度和计划。</p> <p><b>2、公司主要设备在3D封装、HBM等新兴领域的应用情况，是否取得订单，及未来收入贡献情况。</b></p> <p>答：</p> <p>（1）目前公司无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设</p>

	<p>备、三维形貌量测设备等设备已全面覆盖晶圆级先进封装领域中的量产需求,在该领域的国内主流先进封装产能的扩产中占据了大部分市场份额,建立了较好的产品口碑和客户基础。</p> <p>(2) 公司在先进封装凭借已有产品的基础以及与客户深度合作关系,能够有效配合多家国内先进封装领域的头部客户在 3D 封装、HBM 等新兴技术领域上的需求,多款设备已通过验证。</p> <p>(3) 这些新兴领域的未来收入贡献情况主要取决于下游客户的扩产计划,凭借公司目前的客户储备和产品基础,如果下游客户有相关扩产需求,公司将相应受益。</p> <p><b>3、公司收入构成及订单分应用领域构成情况。</b></p> <p>答:</p> <p>公司客户类型丰富,包括了前道制程里面的逻辑、存储、功率和 MEMS 芯片,化合物半导体、先进封装和硅片及制程设备领域客户。其中,前道制程收入占比约 80%,先进封装约 15%。</p> <p>具体到前道制程各细分领域,公司各个系列设备能够同时满足不同领域的技术要求,各年度收入和订单构成情况取决于这个期间不同类型下游客户的扩产情况。</p> <p><b>4、公司未来研发费用率变动情况。</b></p> <p>答:</p> <p>(1) 公司研发投入以及收入均呈现增长趋势,公司未来重点的研发投入领域主要聚焦两方面,一是现有成熟设备的持续迭代升级仍然需要较大的研发投入;另一方面是已完成样机研发的几款重点产品,包括明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备、光学关键尺寸量测设备(OCD)以及软件等,从小批量出货到全面量产、取得竞争优势都需要保持高水平的研发投入。</p> <p>(2) 公司过去几年研发投入保持持续增长,研发费用率在一定区间内波动,研发投入持续增长,但研发费用率根据不同年度的实际情况发生一定波动。</p>
附件清单(如有)	附件 1《与会单位名单》
日期	2024 年 5 月 17 日

## 附件 1 《与会单位名单》

机构名称（排名不分先后）
博时基金
诚旻投资
大家资产
东方基金
国寿资产
合众资产
恒越基金
华夏基金
华夏久盈
汇安基金
嘉实基金
景顺长城基金
诺安基金
申万菱信基金
泰康保险
泰康基金
新华基金
银华基金
长盛基金
中金资管
中邮基金